

反射用レプリカ解析システムASA-03RXD

スピーディで豊富な解析項目と、簡便な操作性を実現



ASA-03RXDの特徴

- レプリカキットはキメ・シワ等の溝にすばやく入り込み、約1分間で硬化させ、誰でも短時間で簡単・確実に皮膚のレプリカを採取可能。また白色単色のレプリカにより皮膚の色素、毛、油分等の影響を受けずに正確なキメ・シワ等の評価が可能になります。
- 専用の解析ソフトはキメ・シワ等の識別を自動認識で行い、個数、体積、面積等を自動的に計算するとともに、識別された部位を着色表示できます
- 高性能デジタル画像処理により、高精度な測定が可能
- 採取したレプリカを専用マウントに固定する事により、レプリカ自体の変形、位置ずれが少なくし、キメ・シワ等の走向に合わせたレプリカの撮影が可能



別売反射用レプリカキット

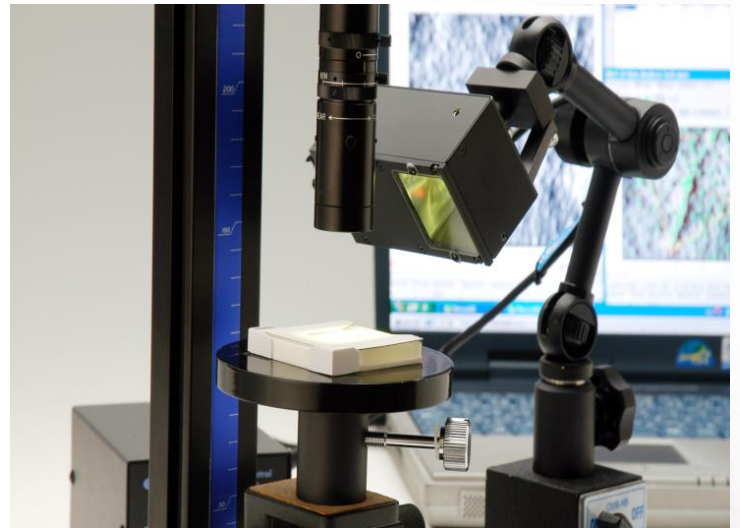
構成	
シリコン液(100CC)	1
凝固液(5CC)	1
サンプリングテープ(100枚)	1
レプリカマウント(100枚)	1
カバーテープ(100枚)	1
混合カップ	1

測定原理 (特許出願済)

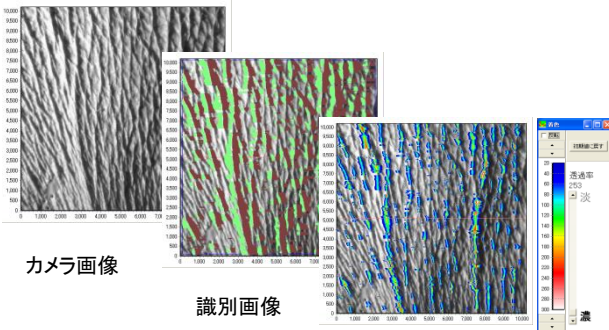
反射用レプリカ解析システムASA-03RXDは採取したレプリカに平行光を角度30度で照射する事により、得られるキメ・シワ等の形状に応じた陰影画像をCCDカメラで撮像し、専用解析ソフトで画像処理することによりキメ・シワ等の形状、定量解析を行います。

シワでは得られた解析画像を基に深度に応じた色が変化するため、合成画像による深度の変化が捉えやすくなりました。

また、キメではヒストグラムでキメの分布状況の変化が確認出来ます。



測定例



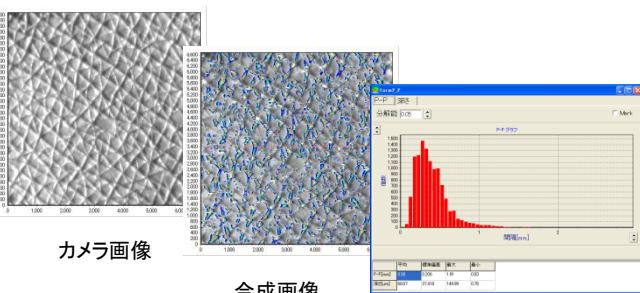
カメラ画像

識別画像

合成画像

全個数	シワ個数	全平均深	シワ平均深	シワ最大深	シワ平均幅	シワ最大幅	全長
N/mm	N/mm	ΣD/mm	ΣD'/N'	D' Max	ΣW/N'	W' Max	mm
0.31	0.31	90.18	288.7	366.8	580.9	611.8	9.58
全体積率	シワ面積	シワ体積率	シワ最大深	シワ最大幅	シワ平均深	シワ平均幅	エリア面積
ΣWD/XY	ΣW'/XY	ΣWD'/X'	Max D'	Max W'	ΣD'/N'	ΣW'/N'	XY-Dot
466.2	1.38	452.4	752.41	1353.12	263.96	409.85	100.43

シワ解析



カメラ画像

合成画像

ヒストグラム

Rz	均一率	全個数	全平均深	キメ個数	キメ平均深	キメ平均幅	全長
平均振幅	Rz/Rt	N/mm	ΣD/mm	N'/mm	ΣD'/N'	ΣW'/N'	mm
126.60	0.879	2.06	144.9	1.87	68.2	132.8	5.32
全体積率	シワ面積	シワ体積率	シワ最大深	シワ最大幅	シワ平均深	シワ平均幅	エリア面積
ΣWD/XY	ΣW'/XY	ΣWD'/X'	Max D'	Max W'	ΣD'/N'	ΣW'/N'	XY-Dot
165.9	2.67	147.3	89.99	259.60	51.37	100.19	36.31

キメ解析

■ 仕様構成

- ・反射用レプリカ撮像ユニット
画像撮像CCDカメラ
平行光照射装置
反射用スライドスロットル
反射用キャリブレーションディスク
- ・反射用レプリカキット
- ・専用遮光カーテン
- ・解析ソフトウェア

■ 解析ソフトウェア仕様

- ・ラインキメ解析 (Rz, Rt, 全個数, 平均深度, キメ個数, キメ平均深度, キメ平均幅)
- ・エリアキメ解析 (全体積, 面積率, キメ体積, キメ最大深度, キメ平均深度, キメ最大幅, キメ平均幅)
- ・ラインシワ解析 (全個数, 平均深度, シワ個数, シワ平均深度, シワ最大深度, シワ最大幅)
- ・エリアシワ解析 (全体積, 面積率, シワ体積, シワ最大深度, シワ平均深度, シワ最大幅, シワ平均幅)
- ・キャリブレーション (XY, 影の長さ→深度変換)
- ・環境設定 (キメ解析設定, シワ解析設定) ・その他 (3次元表示, エッジ強調)
- ・作動環境 Windows 8・10

改良の為、お断り無く外観及び仕様を変更することが有ります。

販売元

日本アッシュ株式会社

〒192-0081
東京都八王子市横山町3番6号 八王子横山町JEビル7F
TEL042-648-5350 FAX042-648-5332
URL <http://www.j-asch.co.jp>

改良の為、お断り無く外観及び仕様を変更することが有ります。